



# ミライアル株式会社 2012年1月期 第1四半期決算説明資料

2011年6月10日




Mirai ミライアル株式会社



# 目次

2012年1月期 第1四半期決算概要.....	2
2012年1月期業績予想.....	9
(ご参考1)弊社を取り巻く業界環境.....	12
(ご参考2)今期の施策.....	14



# 2012年1月期 第1四半期決算概要

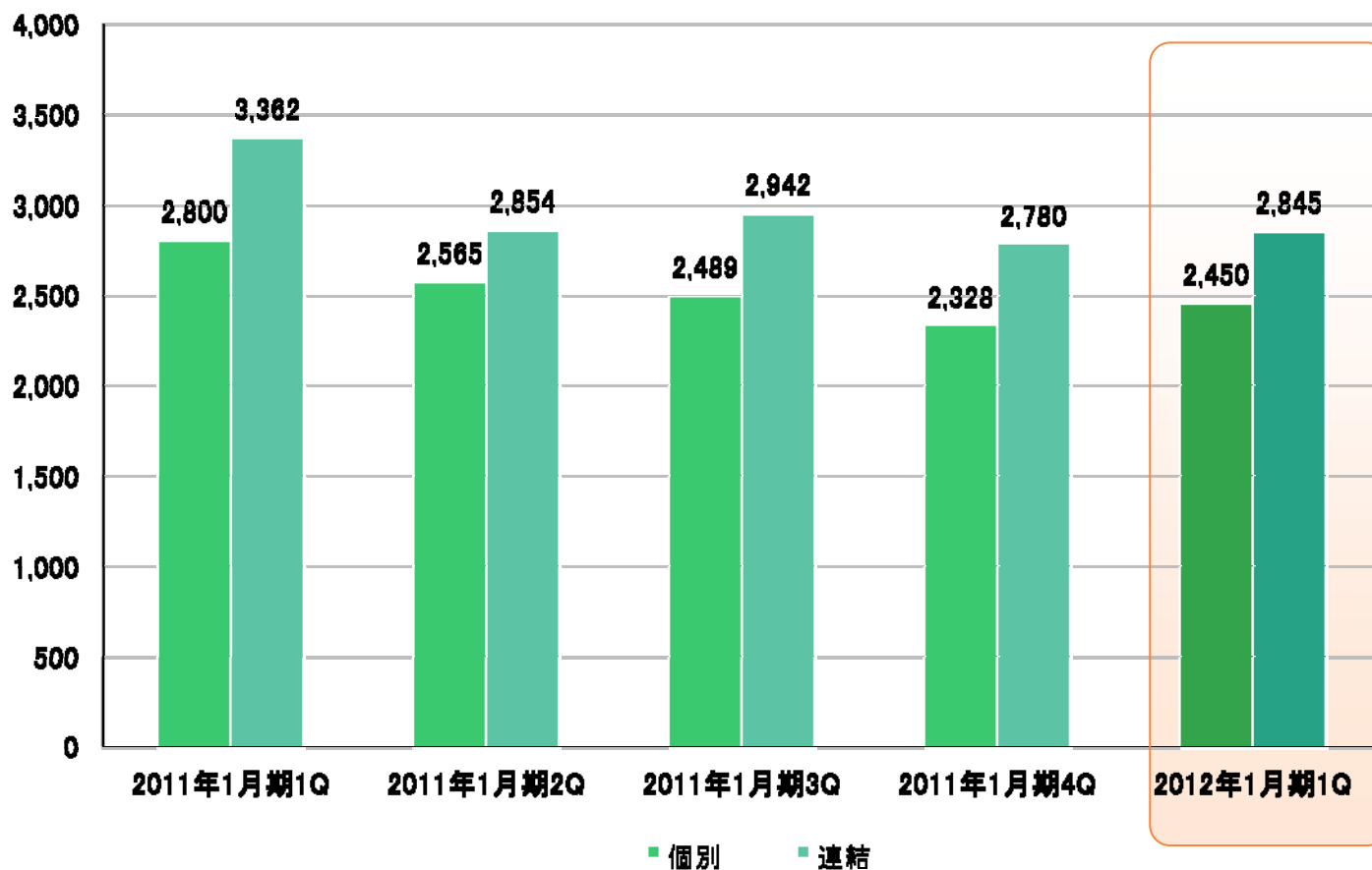


# 1. 業績ハイライト

- 連結売上高については、前4Qから2.3%増の28億45百万円でした。
- 個別売上高については、前4Qから5.2%増の24億50百万円でした。
- ミライアル単体は、主要顧客であるシリコンウエハメーカー、半導体デバイスメーカーにおいても、震災の影響を受け、一部顧客においては、先行不透明な状態となり、売上高は厳しいものとなりました。
- 連結子会社である(株)山城精機製作所は、前期からの収益改善策と積極的な営業政策を実施しましたが、売上高は低調なものとなりました。

## 売上高推移(四半期毎)

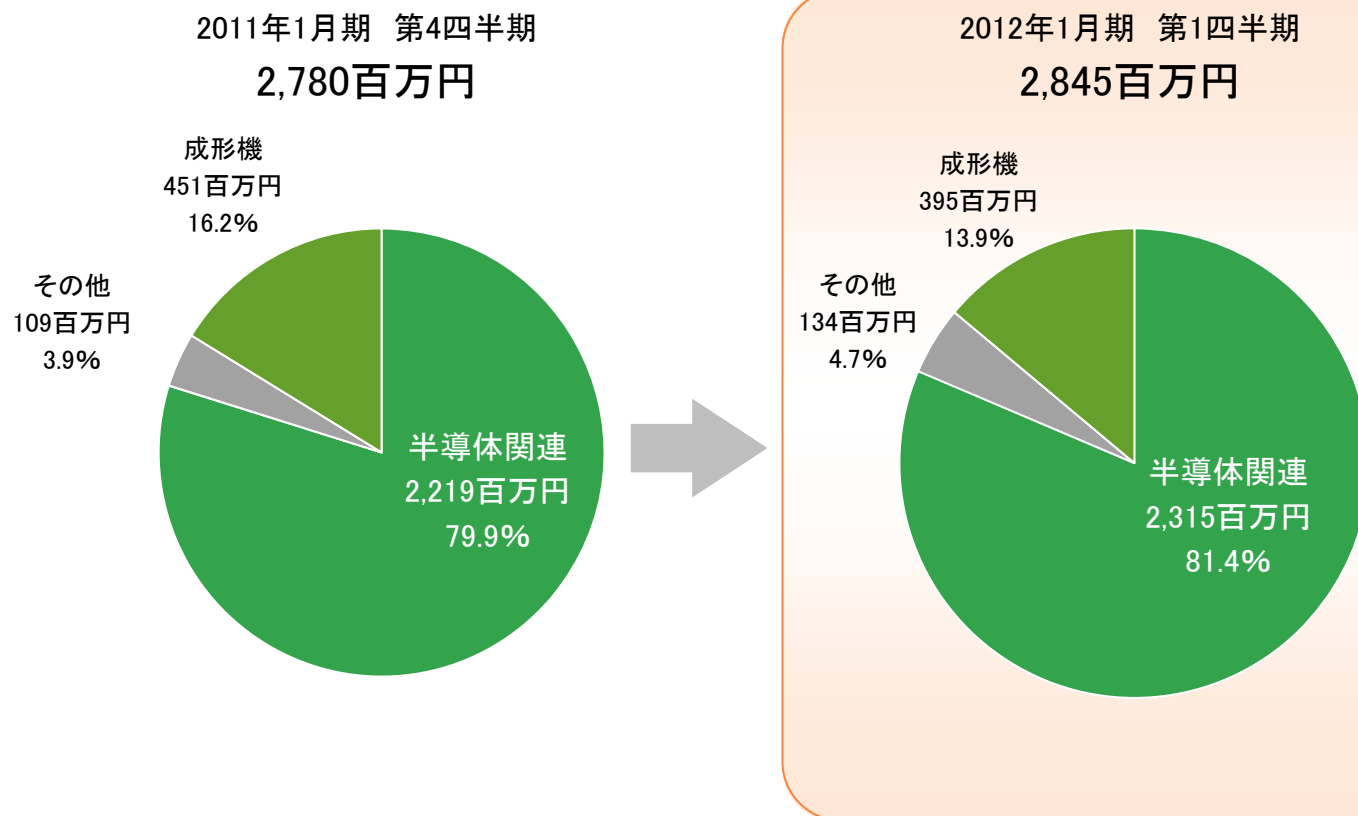
(単位:百万円)



## 2. 事業別売上高の比較

- プラスチック成形事業は、主力製品である300mmシリコンウエハ出荷容器「FOSB」における東日本大震災による主要顧客の稼働停止、半導体業界への直接的な震災の影響等により、売上高は横ばいとなりました。
- プラスチック成形事業
  - 半導体関連事業については、前4Qと比較すると4.3%増の23億15百万円でした。
  - その他事業については、前4Qと比較すると23.0%増の1億34百万円でした。
- 成形機事業
  - 前4Qと比較すると12.4%減の3億95百万円でした。

### 事業別売上高(連結)

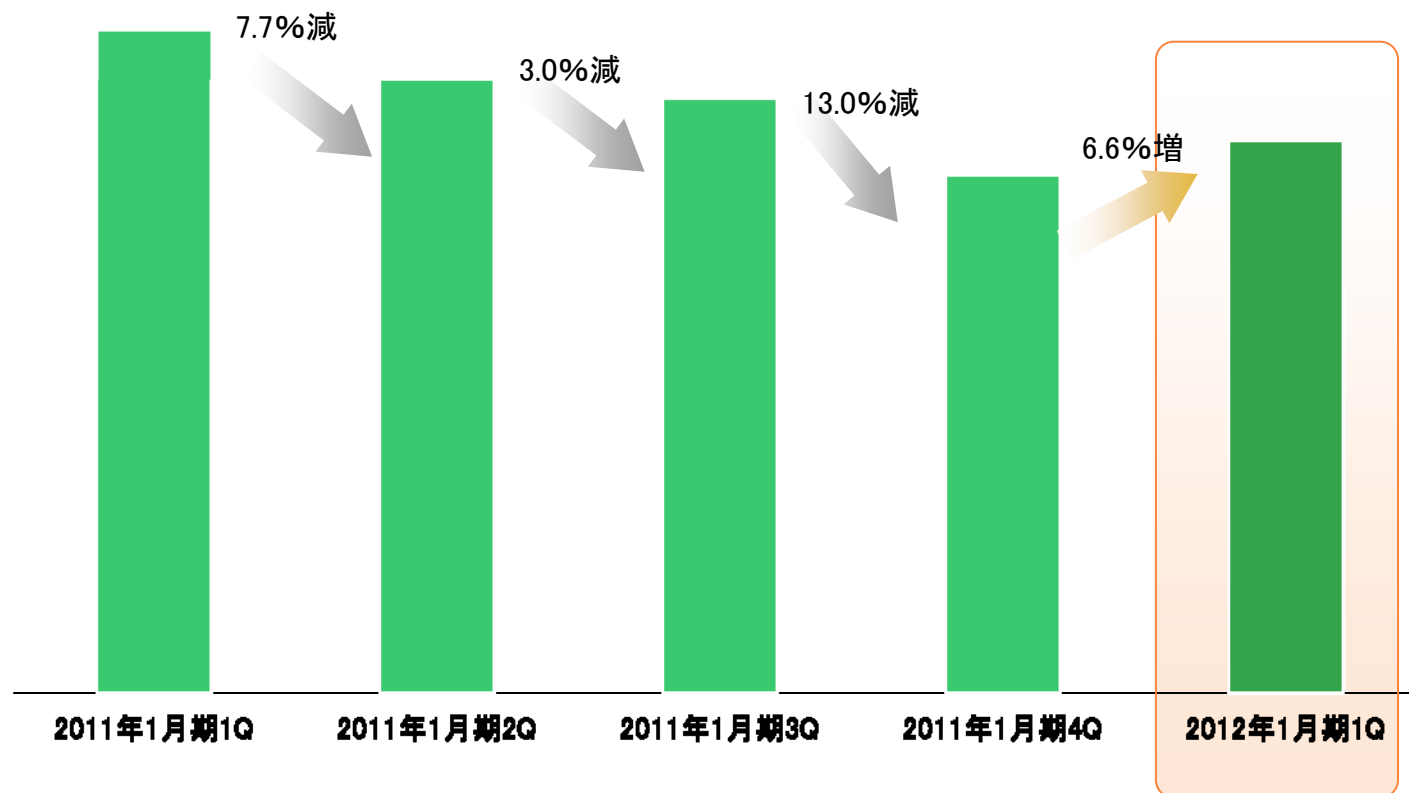




### 3. 半導体関連事業の業績

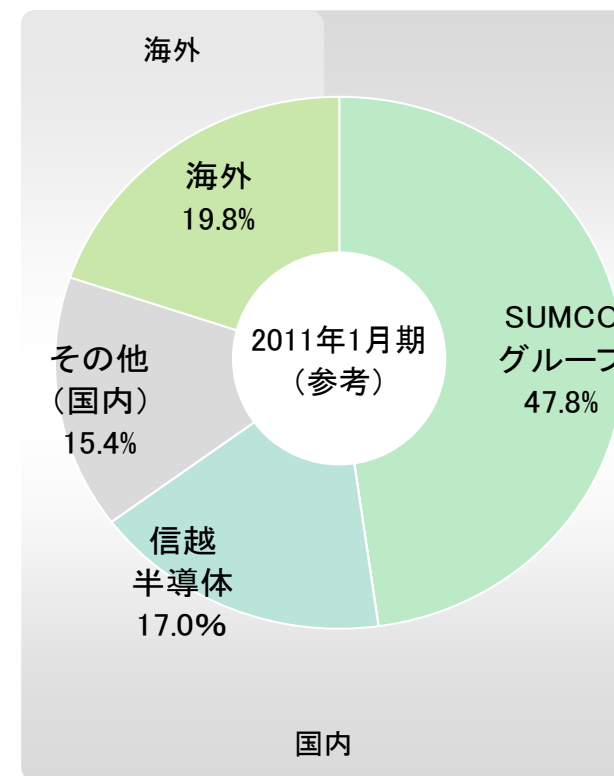
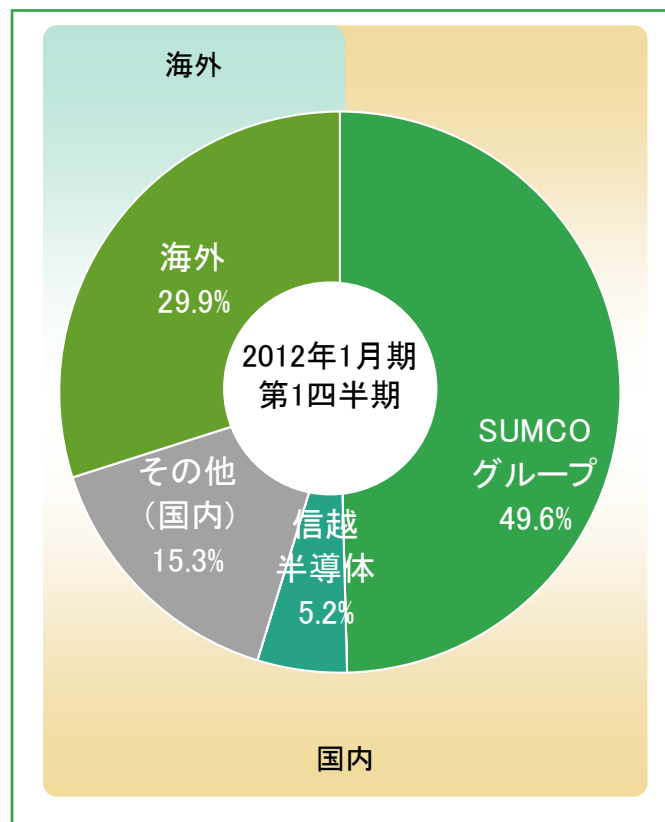
- 出荷容器においては、前4Q比6.6%増となっております。
- 工程内容器においては、半導体需要の不透明感・設備投資の凍結の影響を受け、前4Q比8.3%減となっております。

#### シリコンウエハ出荷容器 売上高の推移(四半期毎)



## 4. FOSB出荷実績得意先別シェア

### 弊社FOSB出荷実績得意先別シェアの動向



## 5. 2012年1月期 第1四半期会計期間決算概要

### 連結業績

(単位:百万円・%)

	2011年1月期 第1四半期会計		2012年1月期 第1四半期会計	
	金額	前年同期 増減率	金額	前年同期 増減率
売上高	3,362	79.9	2,845	△15.4
売上総利益	1,472	516.2	1,015	△31.0
営業利益	990	-	516	△47.9
(営業利益率)	29.4		18.1	
経常利益	1,143	-	542	△52.5
税引前当期純利益	1,343	-	502	△62.6
当期純利益	813	-	199	△75.5
設備投資	24		6	
減価償却	147		111	
純資産	15,491		15,462	
総資産	20,284		19,479	

### 個別業績

(単位:百万円・%)

	2011年1月期 第1四半期会計		2012年1月期 第1四半期会計	
	金額	前年同期 増減率	金額	前年同期 増減率
売上高	2,800	84.9	2,450	△12.5
売上総利益	1,287	549.1	884	△31.3
営業利益	955	-	518	△45.7
(営業利益率)	34.1		21.1	
経常利益	1,050	-	514	△51.0
税引前当期純利益	1,251	-	495	△60.4
当期純利益	748	-	292	△60.9
設備投資	6		5	
減価償却	137		102	
純資産	14,377		15,281	
総資産	17,808		18,103	

- 当期純利益については、連結子会社の法人税率変更に伴う法人税等調整額104百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額62百万円の計上等もあり、減少しております。






## (ご参考) キャッシュフロー(連結)

### キャッシュフロー

(単位:百万円)

	2011年1月期 第1四半期	2012年1月期 第1四半期	増減
営業活動によるキャッシュフロー	639	246	△393
投資活動によるキャッシュフロー	△78	△2,016	△1,938
財務活動によるキャッシュフロー	△418	△690	△271
有利子負債減少	△155	△386	△231
配当金支払	△303	△303	0
現金及び現金同等物期末残高	6,547	4,974	△1,572

- 投資活動によるキャッシュフロー△2,016百万円は、主に3ヶ月超1年未満の定期預金に振り替えたことによる減であります。



# 2012年1月期業績予想



# 1. 業績予想サマリー

## 東日本大震災における影響について

- 当連結会計年度の業績予想につきましては、震災による影響が今後も懸念され、先行きが不透明な状況であります。現時点では業績予想の変更はいたしません。今後、必要となった場合または先行きが見通せるようになった場合は、速やかに修正いたします。

## 売上高(当初予想の前提)

- 世界全体の半導体市場規模は、景気循環の影響を受けながらも、マクロ的には拡大を続けていく見通しです。
- 今年度のFOSB需要は、昨年後半より需給バランスの悪化から需要は減少しましたが、今年度末の300mmウエハの生産量を月産410万枚と予想し、前年度比伸び率二桁を予想しています。
- FOSBのリユースについては、足下で全体の容器量の内、30%前後で推移していると予想しています。今後も急激な増加はないと見込んでいます。
- 子会社の山城精機は、昨年度は政府の景気刺激策により、成形機業界の需要は自動車産業や家電の消費拡大により回復傾向となりました。今年度も引き続き、自動車産業の環境対応車に関連する電気部品等の需要増や環境、バイオサイエンスなどの最先端成長分野についての需要増を見込んでいます。

## 営業利益、経常利益(当初予想の前提)

- グループでのコラボレーションを強化し、更なるコストダウンを実施します。
- 設備投資は、合理化及び品質維持に要する設備投資に限定しています。
- 450mm関連投資は、必要に応じ実施します。

## 2. 業績予想

### 損益計算書(連結)

(単位:百万円・%)

	2011年1月期		2012年1月期(予)			
			2012年1月期 第2四半期累計			金額
	金額	前期増減率	金額	前期増減率	金額	
売上高	11,939	22.6	6,200	△0.3	12,630	5.8
営業利益	2,911	76.0	1,390	△18.1	3,110	6.8
経常利益	3,179	63.7	1,530	△19.2	3,300	3.8
(当期)純利益	2,191	129.8	930	△35.1	2,020	△7.8

### 事業別売上高

(単位:百万円・%)

	2011年1月期			2012年1月期(予)					
				2012年1月期 第2四半期累計			金額	構成比	前期 増減率
	金額	構成比	前期増減率	金額	構成比	前期増減率			
プラスチック成形事業	10,184	85.3	19.4	5,080	81.9	△5.3	10,430	82.6	2.4
半導体関連	9,697	81.2	17.9	4,850	78.2	△5.0	9,950	78.8	2.6
その他	486	4.1	58.1	230	3.7	△12.6	480	3.8	△1.4
成形機事業	1,755	14.7	45.6	1,120	18.1	31.5	2,200	17.4	25.3
合計	11,939	100.0	22.6	6,200	100.0	△0.3	12,630	100.0	5.8



# 弊社を取り巻く業界環境

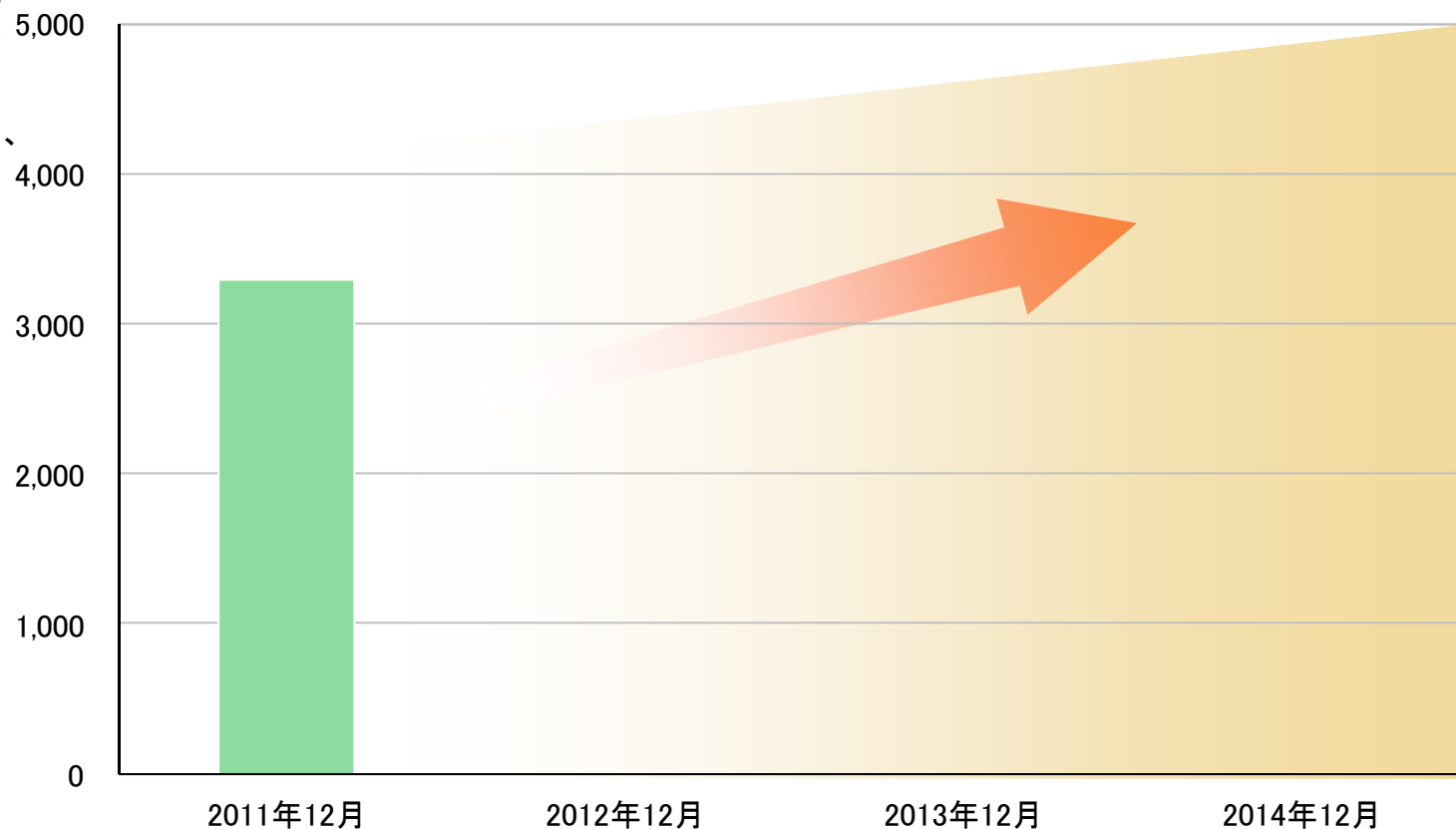


## シリコンウエハ市場の動向

- 東日本大震災における影響により、短期的に先行き不透明なもの、半導体用途の拡大に伴い、シリコンウエハの需要は、増減の波はありながらも、300mmを中心に伸びていくと予想される。

### 300mmウエハの需要予想

(千枚/月)



出所: 弊社推測



# 今期の施策



## 今期の方針

### 半導体関連事業

- ① 現存事業の安定利益源化
- ② 新たな収益資源の構築
- ③ 会社基盤の強化

### 成形機事業

山城精機の重点施策





## ①現存事業の安定利益源化

### 業界品質No.1と更なるコストダウンで競争力の強化

#### 出荷容器

- マーケット拡大に比例した利益獲得を徹底追及(300mm)
- 品質造り込み(品質での競争力)
- 次世代に向けたシェア獲得準備(450mm)

#### 工程内容器・カセット 他

- 製・販・技一体となった高利益率製品の販売拡大および新製品開発



## ②新たな収益資源の構築

### 事業領域の拡大及び新規事業領域への展開を推進

#### 新規事業創出

- 【外部リソースの活用】  
業務提携/産学連携/M&A
  - 【内部リソースの活用】  
自社開発
- 事業ドメインの拡大・多角化による事業リスクの分散を主目的とする
  - 自社開発、産学連携、共同開発、M&A等、外部資源の活用を視野に入れる

#### 新製品開発

- 【内部リソースの活用】  
自社開発
- 現在の事業ドメイン内での新製品にかかる開発であり、450mm対応、後工程への展開を推進する
  - 半導体分野をターゲットに、当社コア技術を活用し、社内連携を通じてニーズに応えていく
  - 営業、技術、製造が一体となつての推進を徹底強化する



## ③会社基盤の強化

1

山城精機とのコラボレーション強化

2

安定した収益基盤と財務健全性の確立



## 山城精機の重点施策

### 「縦型機のNo.1メーカー」への 取り組み

- シェアアップ
  - 汎用成形機、LIM成形機、圧縮・トランスファー成形機
- No.1商品の創出
  - 新成形システムの開発企画推進

### 高効率生産体制の構築

- 少数精鋭での増産体制を構築
- 価格競争力を高め利益を極大化



# 本日はありがとうございました

## 「ミライアルの未来」

明日に向かって

## 「未来を見つめ」「未来を考え」「未来を創る」

夢と創造に挑戦

### IR問い合わせ窓口

ミライアル株式会社 経理部

電話:03-3986-3782 FAX:03-3986-3853 E-Mail:investor\_relations-m@miraial.co.jp

#### <将来見通し等に関する注意事項>

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できるとされる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。